

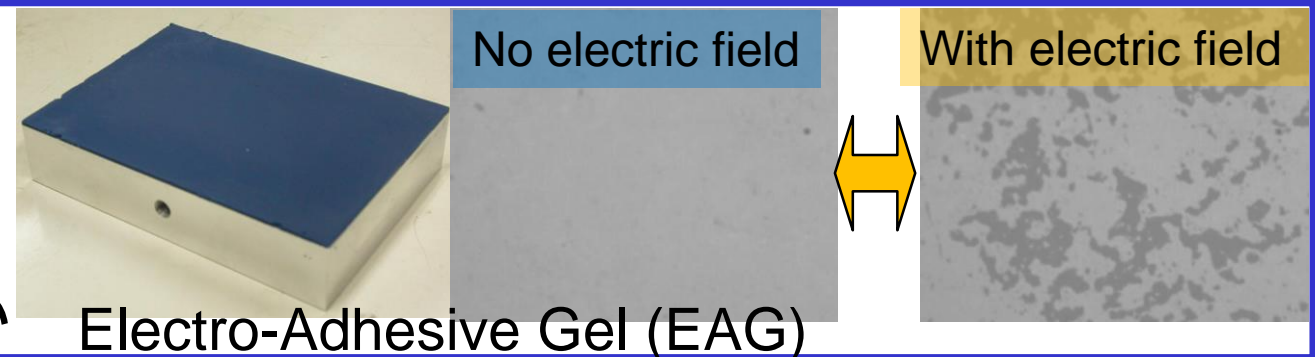


Development of the electro adhesive pillar array using electrostatic induction lithography

Background

微細半導体の需要増加に伴い
正確かつ効率的な搬送が求められる

従来のチャック技術に優位性を持つ
電気粘着ゲルは個体差が問題となり安定性が弱い

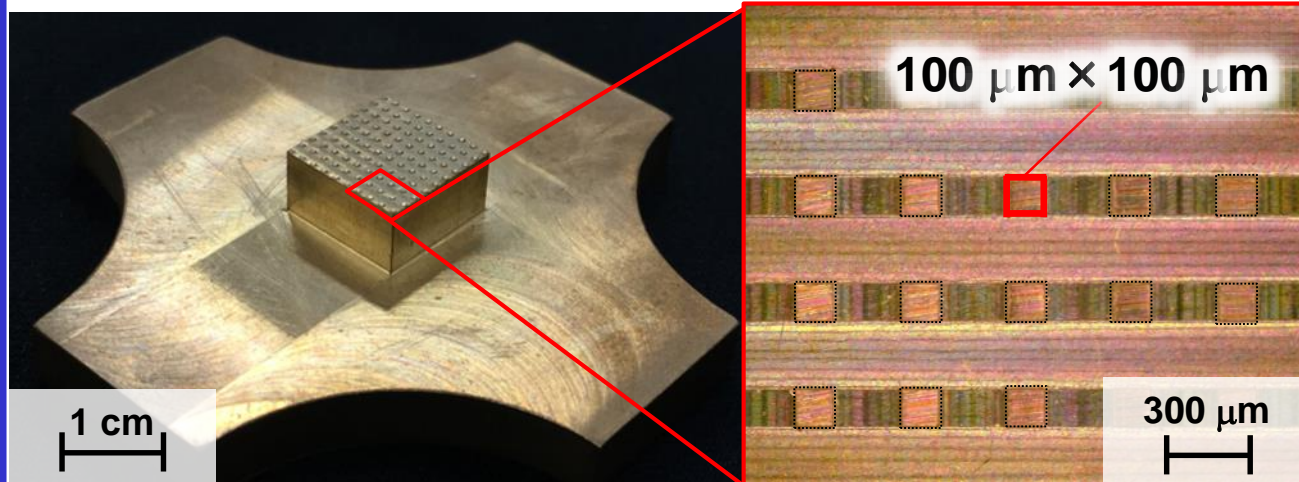


Research purpose

規則性を持つ電気粘着微細ピラーアレイの安定的な作製と実験的評価

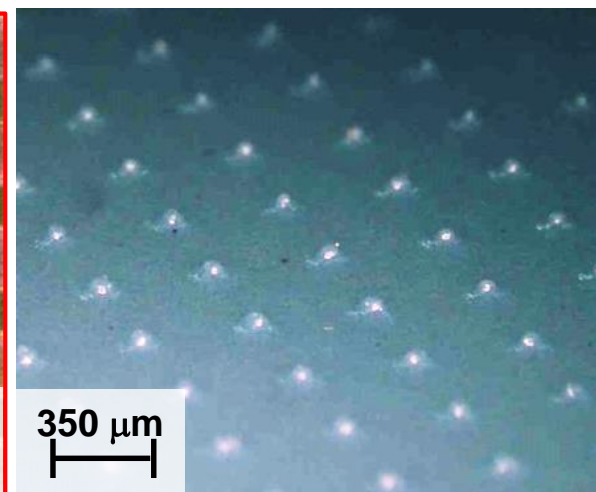
Methodology & Results

◆ パターンを施したテンプレートによる静電誘導
リソグラフィを用いて規則的な構造体を形成する



Using template

◆ 作製した構造体の固定力を測定すると印加
電場に応じて変化した



EA pillar array

